

## 請求の範囲

- [1] 電子部品にペーストを転写するペースト転写装置において、  
上記電子部品を接触させるペースト膜がその上面に形成される平滑な膜形成面を備えたベース部と、  
上記ベース部に沿って水平移動可能に備えられた移動部材と、  
揺動支点廻りの揺動が可能に上記移動部材に結合され、上記移動部材とともに往復動するブレード保持部と、  
上記揺動支点の上記往復動の方向における位置を挟むように、上記往復動の方向に相隔てて上記ブレード保持部に装備された第1のブレードおよび第2のブレードと、  
上記ブレード保持部における上記揺動支点から隔てられた位置を駆動作用点として、往復駆動力を伝達する往復動機構と、  
上記ブレード保持部の揺動時の揺動抵抗に打ち勝つ大きさの制動抵抗で上記移動部材を上記往復動機構による駆動方向と反対方向に制動する制動機構とを備え、  
上記移動部材の往動時に、上記第1のブレードまたは第2のブレードのいずれか一方のブレードを上記ベース部に接触させながら移動させ、復動時に他方のブレードを上記ベース部に接触させながら移動させる、ペースト転写装置。
- [2] 上記第1のブレードは、上記膜形成面上に予め定められた膜厚のペースト膜を形成する成膜用のブレードであり、  
上記第2のブレードは、上記膜形成面上に存在するペーストを掻き取る掻き取り用のブレードである、請求項1に記載のペースト転写装置。
- [3] 上記成膜用のブレードにおける上記ベース部との接触部分に上記膜厚に対応した深さの切り欠き部が設けられ、  
上記掻き取り用のブレードは、上記ベース部の上記膜形成面に接触するように形成されている、請求項2に記載のペースト転写装置。
- [4] 上記ベース部の上面に、その底面が上記膜形成面として機能し、かつ上記膜厚に対応した深さの凹部が設けられ、上記掻き取り用のブレードは、上記凹部の底面に接触するように形成されている、請求項2に記載のペースト転写装置。

- [5] 上記第1のブレードと第2のブレードとの間に、上記膜形成面から掻き取られたペーストを貯留するペースト貯留部が備えられている、請求項1に記載のペースト転写装置。
- [6] 電子部品を保持して基板に実装する実装ヘッドと、  
上記基板を保持する基板保持部と、  
上記実装ヘッドを上記基板保持部に対して移動させて位置決めを行うヘッド移動装置と、  
上記ヘッド移動装置による上記実装ヘッドの移動経路に配置され、上記実装ヘッドにより保持された上記電子部品に、ペーストを転写する請求項1から5のいずれか1つに記載のペースト転写装置とを備える、電子部品実装装置。